

上海建桥学院课程教学进度计划表

一、基本信息

| | | | |
|------|--|------|---------------------------|
| 课程代码 | 2080076 | 课程名称 | 集成电路封装技术 |
| 课程学分 | 3 | 总学时 | 48 |
| 授课教师 | 许玉娥 | 教师邮箱 | xuyue@gench.edu.cn |
| 上课班级 | 微电子 B14-1 | 上课教室 | 三教 103/一教 204 |
| 答疑时间 | 时间： 周二下午 5.6 节 地点： 5430 电话：18817539568 | | |
| 主要教材 | 集成电路芯片封装技术 李可为 电子工业出版社 2013.7 | | |
| 参考资料 | 电子组装制造 Harper.C.A 贾松良等译校 科学出版社 2005.2 | | |

二、课程教学进度

| 周次 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
|----|-----------------|------|-----|
| 1 | 集成电路封装技术绪论 | 讲课 | |
| 2 | 传统集成电路封装技术 | 讲课 | 作业一 |
| 3 | 芯片互连技术-WB, TAB | 讲课 | 作业二 |
| 4 | 可靠性设计 | 讲课 | |
| 5 | 热控制基础 | 讲课 | |
| 6 | 课堂测验 | 测验 | 作业三 |
| 7 | 倒装焊技术 | 讲课 | |
| 8 | 焊球阵列封装和芯片尺寸封装 | 讲课 | |
| 9 | 圆片级封装技术 | 讲课 | |
| 10 | 三维封装技术 | 讲课 | 作业四 |
| 11 | 分立、集成和嵌入的无源元件基础 | 讲课 | |

注：课程教学进度计划表电子版公布在本学院课程网站上，并发送到教务处存档。

| | | | |
|----|------------|----|-----|
| 12 | 印刷电路板基础 | 讲课 | 作业五 |
| 13 | 电路板组装制造 | 讲课 | |
| 14 | 封装中的材料 | 讲课 | |
| 15 | 封装的密封与包封基础 | 讲课 | 作业六 |
| 16 | 复习所学知识 | 复习 | |
| 17 | 考试周 | 考试 | |

三、评价方式以及在总评成绩中的比例

| 项目 | 期末考试 (1) | 过程考核 1 (X1) | 过程考核 2 (X2) | 过程考核 3 (X3) | 过程考核 4 (X4) | |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 考核形式 | 闭卷 考试 | 作业 | 笔记 | 课堂表 现 | 课堂 测验 | |
| 占总评成 绩的比例 | 50% | 10% | 10% | 10% | 20% | |

任课教师：许玉娥

系主任审核：喻玲

日期：2016.9

注：课程教学进度计划表电子版公布在本学院课程网站上，并发送到教务处存档。